용어	의미
PRINT 배선판 (다층 PRINT 배선판)	회로부품을 접속하는 전기배선을 호로설계에 기초하여 배선형태로 표현한 것을 적당한 방법으로 절연물위에 전기도체로 재현한 것을 말하고, 그중에서 다층 PRINT 배선판이라는 것은 각 도체층간을 프리프레그로 일체화하여 3층이상의 도체층을 THROUGH HOLE도금법에 의해 제작한 것을 말한다.
동박면	동적층판(Copper Clad Laminate)에 있어, 동박의 표면을 말한다.
접착면	동적층판에 있어 동박을 제거한 면을 말한다.
적층판면	동적층판에 있어 동박을 접착하지 않은 면을 말한다.
내층면 외층면	다층 PATTERN 구성중에서 표면에 노출되지 않은 도체면을 내층면 이라고 한다. 이 내층면에 대해 표면에 도출되어 있는 도체면을 외층면 이라고 한다.
프리프래그 (PREPREG)	SHEET 상태의 재료(예, Glass포)에 수지 (예, EPOXY 수지)를 함침시켜 반경화상태로 한 것으로 다층 PRINT배선판의 제조에 있어 복수의 도체층을 접착하기 위한 것으로 쓰인다.
절연층	겹겹인 도체층사이에 있는 절연물로 된 층을 말한다.
도체층	도체 PATTERN이 형성되고 있고 THROUGH HOLE로 연결되는 층을 말한다. 다층 PRINT 배선판은 3층 이상의 도체층을 갖는다.
HOLE	HOLE이란, 부품의 단자, 전기접속용 LEAD선을 통과하기 위한 것 및 도체층 상호간을 접속하는 것을 말한다.
LAND	LAND란 부품의 접속 또는, 부착하기 위한 목적으로 사용되는 도체 PATTERN의 일부를 말한다.
SMD LAND	표면실장용 부품을 탑재, 접속하기 위한 도체 PATTERN의 일부를 말한다.

THROUGH HOLE 도금법	도체층 상호간의 접속 등 필요한 곳에 관통출을 설치, 화학도금 또는 화학도금과 전기도금에 의해 내벽도금층을 생성시켜 도체층 상호간을 접속하는 방법을 말한다.
단자	CONNECTOR에 삽입항 접속하는 것을 목적으로서, PRINT베선판의 단자에 설치한 부분을 말한다.
ETCHING	절연판에 접착한 동박의 불필요한 부분을 화학적으로 제거하는 법을 말한다
프리플럭스	동표면이 산화되지 않도록 도포하는 유지류를 말한다.
MINI VIA HOLE PRINT 배선판	도체상호간의 접속을 목적으로한 소경 THROUGH HOLE (0.6mm미만)을 사용한 PRINT 배선판의 총칭을 말한다.
TH	Plated-Through Hole HOLE 내벽이 도금되어 도통되는 HOLE
NTH	Non Plated-Through Hole HOLE 내벽이 도금되지 않아 비통되는 HOLE
CLEARANCE HOLE	다층 PRINT 배선판에 있어 HOLE과 전기적 접속을 하지 않기 위해 HOLE을 둘러싼 도체 PATTERN의 도전채료가 없도록 한 영역
SOLDER LEVELLING	충분한 열과 기계적 힘을주어 PRINT 배선판에서 용융한 SOLDER를 재분포 및 부분적 제거하여 균일한 SOLDER표면을 만드는 작업을 말한다.
HOT AIR LEVELLING	열풍으로 여분의 SOLDER를 제거하여 표면을 매끄럽게 하는 방법
DIP SOLDERING	부붐을 부착한 PRINT 배선판을 용융한 납땜함의 정지 표면상에 접촉시켜서 노출한 도체 PATTERN과 부품의 LEAD선 전부를 동시에 납댐하는 방법
REFLOW SOLDERING	접합하고자 하는 부분에 미리 설치한 납을 용융시킨 것에 의해 시행하는 납땜 방법
FLOW SOLDERING (WAVE SOLDERING)	순환하는 납의 표면에 PRINT 배선판을 접촉시켜 납땜하는 방법

VPS (Vaout Phase Soldering)	고비점 가스로 납땜 용융 온도점을 만들어 REFFLOW SOLDERING를 하는 방법

용어	의미
DIP	Dual In-Line Package
SH-DIP	Shrink DIP. 표준 DIP보다 Lead Pitch를 100mil(2.54mm)에서 70mil(1.78mm)로 축소한 것을 말한다
SK-DIP	Skinny DIP. 표준 DIP보다 ROW SPACE를 300mil까지 축소한 것을 말한다
SL-DIP	Slim DIP. 표준 DIP보다 ROW SPACE를 400mil까지 축소한 것을 말한다
SIP	Single In-Line Package
ZIP	Zig-Zag IN Package. SIP의 PIN을 엇비슷하게 교차시키는 것을 말한다
PGA	Pin Grid Array Package. Package 표면에서 수직방향으로 일정간격 격자상에 LEAD가 나와 있는 구조로 된 것을 말한다.
SMT	Surface Mounting Technology. 표면 실장 기술
SMD	Surface Mounting Device. 표면 실장 부품
SPO	Small Out Line Package. FLAT형 Package의 2측면에서 평면적으로 LEAD가 나온 것을 말한다
QFP	Quad Flat Package. FLAT형 Package의 4측면에서 평면적으로 LEDA가 나온 것을 말한다
LCC	Leadless Chip Carrier Lead를 없애고 SOLDERING되는 전극만을 형성한 것을 말한다

PLCC	Plastic Leaded Chip Carrier Lead를 4측면에서 J자형으로 구부려 가공한 것을 말한다
SOJ	Smail Out Line J Lead Package Lead를 2측면에서 J자형으로 가공한 것을 말한다.
COB	Chip On Board
TAB	Tape Automated Bonding
HIC	Hybrid Integrated Circuit
CAD DA	Computer Aided Desing Design Automation 자동설계
EMI	Interference Electromagnetic. 전기통신 (통신/전자) 기기의 실효특성에 방해를 주거나 또 기타 감쇠 시키거나 제한을 주는 각각의 전자 에너지를 말한다.
CAE	Computer Aided Engineering. Computer를 이용한 지원해석(회로 SIMULATION 등)
MCM	Muitl Chip Moduie
BGA	Ball Grid Array
TCP	Tape Carrier Package
CSP	Chip Scale Package